

칩스앤미디어, TSMC 3나노 라이브러리 수령...고객 IP구현 완성도 제고

- ▶ 국내유일 TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼 IP파트너로 첨단공정 라이브러리 지속 협업 예정
- ▶ TSMC의 AI 반도체 고객 성장과 더불어 지속적인 성장

<2024-11-06>

칩스앤미디어가 고객의 TSMC 라이브러리 테스트 완성도를 제고할 수 있는 솔루션을 확보했다.

글로벌 비디오 IP 기술 선도 기업 칩스앤미디어(094360, 대표이사 김상현)는 6일, TSMC를 통해 3나노 라이브러리를 수령했다고 공식 발표했다.

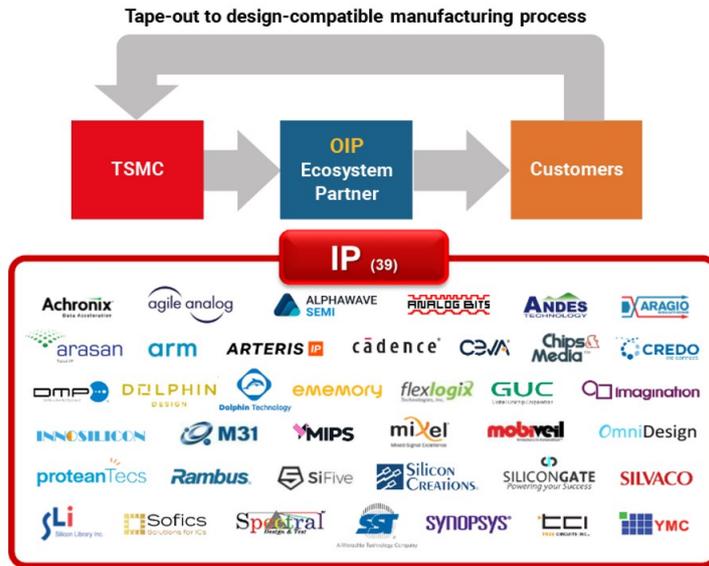
이로써 칩스앤미디어 IP를 기존 TSMC 5nm뿐만 아니라 3nm에서 합성·테스트가 가능하게 됐다. 라이브러리 테스트는 고객이 계약 전 TSMC의 해당 공정으로 칩스앤미디어 IP가 어떤 사이즈로 구현되는지 여부를 미리 확인해 볼 수 있어 칩 개발의 용이성을 한층 높여준다.

칩스앤미디어측은 “해당 라이브러리는 TSMC IP Ecosystem 협력사들 만이 받을 수 있는데, 첨단 공정이 빠르게 발전하고 있어 향후 개발될 2nm 라이브러리까지 받을 것으로 예상하고 있다” 며 “당사는 다년간 TSMC의 OIP 파트너이자 IP Alliance Partner로서 미국에서 개최하는 TSMC의 기술 심포지엄에 꾸준히 참가하며 기술력을 인정받고 있다” 고 강조했다.

실제로 TSMC의 OIP는 반도체 설계 및 제조 전반에 걸친 혁신적 기술 인프라로, 설계 장벽을 낮추고 초기 실리콘 성공률을 높이는 데 중요한 역할을 한다. TSMC의 IP, 설계 구현, 제조 가능성 설계(DFM) 기능을 활용해 파트너들과의 협력하고 이를 통해 반도체 설계 생태계 내에서 고객과 파트너들이 신속하게 새로운 기술을 도입하고, 설계에서 양산, 시장 진입, 수익 창출까지의 시간도 단축시키고 있다.

특히, IP Alliance Program은 OIP의 핵심 요소로서 실리콘 검증 및 양산 경험이 풍부한 IP를 제공하는 글로벌 주요 IP 회사들과의 협력을 통해 TSMC의 IP 생태계를 확장, 강화하고 있다.

김상현 칩스앤미디어 대표이사는 “AI 반도체 시장이 급성장하고 있는 가운데, 당사와 TSMC의 파트너십은 앞으로도 그 중요성이 더욱 커질 전망이다. TSMC의 OIP 파트너로서 AI 반도체 시장에서의 리더십을 강화하고, 기술 혁신을 통해 글로벌 반도체 산업에서 지속 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다” 고 전했다.



TSMC IP Ecosystem Partners

TSMC 제공 (두번째 줄 여섯 번째 칩스앤미디어)